

計画名	研究開発の要約	主たる技術	事業管理機関名	認定事業者名	主たる研究開発の実施場所
<p>高品質シリコンウエハの安定供給のための加工技術と検査技術の開発</p>	<p>半導体シリコンウエハの加工業者は高品質加工技術と出荷を行うべき高いレベルの検査診断技術を確認し、良品を安定して提供する義務がある。ウエハの薄型化が進む現在、極めて重要である。この2つの課題技術に対して、前者は次世代型「炭」砥石開発による低ダメージ加工の実現。後者は光散乱法によるサブミクロンでの診断技術を構築させ、従来技術から脱却し、品質が極めて高いレベルでのシリコンウエハの安定供給を可能にする。</p>	<p>切削加工</p>	<p>財団法人やまなし産業支援機構(山梨県)</p>	<p>アポロ電子株式会社(山梨県)</p>	<p>山梨県</p>